

龍華科技大學 半導體工程系 甄選入學「術科實作」作業規範

93年9月30日化工與材料工程系招生小組訂定
104年10月27日10402次招生委員會修訂
105年11月2日10501次招生委員會修訂
107年10月26日10802次招生委員會制訂
111年10月26日11202次招生委員會修訂

- 一、實作生：共____名
- 二、實作地點(____間)：_____大樓 _____、_____室
- 三、實作協助人員(____人)：_____、_____、_____
- 四、實作日期：_____
- 五、實作時間：_____
- 六、實作方式：多對一
- 七、實作委員：(3人)：_____、_____、_____
- 八、「實作」佔甄選總成績之比例依簡章規定計算，評分項目之配分及評分參考如下表，
評分表格如附件。

項 目	配 分	評 分 參 考
專業能力 術科實作	40分	(1). 機械群—以工程圖識別加工程序 (2). 電機類—三用電表的測量 (3). 資電類—三用電表的測量
表達能力	40分	(1). 專業知識 (2). 創意性 (3). 邏輯性
整體表現	20分	(1). 了解問題核心的能力 (2). 得體表達意見想法的能力

- 九、每位實作生之評分由3位委員評審，取委員之評分平均數為該生之實作成績（計算至小數第二位四捨五入）。
- 十、召集人應於實作前三天內召開實作評分協調會，討論實作項目問題內容、評分標準與注意事項等。
- 十一、實作委員請依照指定地點及時間提前十分鐘到達。
- 十二、各實作教室之實際情形應自實作時間開始後，全程錄影或錄音。
- 十三、實作委員於接受推薦後，不得就甄試相關事宜及分數對外發言，違者由甄選小組提送招生委員會處理，並應遵守相關保密承諾。
- 十四、本系實作評分總表依序號於規定期限內送回教務處。各項報名甄選入學學生之基本資料、甄試生實作評分表與錄影(音)資料，應妥善保存一年以上。

召集人簽名：_____

日 期：_____